

高速傳輸介面晶片

台灣高速傳輸介面 IC 設計領導廠商：智微科技（4925）於今年（2018）年台北國際電腦展針對外接存儲裝置市場發表了一系列全新的高速介面橋接晶片；JMS583（USB 3.1 Gen2 to PCIe Gen3x2）、JMS901（USB 3.1 Gen1 to UFS）、JMS585（PCIe Gen3x2 to SATA 6Gb/s x5）等，並與多家國內外知名存儲裝置設備製造商於會展期間發表相對應的商品與解決方案，應用層面包含了全新超高速外接式存儲裝置、高速讀卡器、嵌入式系統、安防監控主機等。

隨著 4K/8K 與更高解析度影像與各式多媒體裝置的興起，資料傳輸與攜行量日趨龐大，客戶在資料傳輸上常花費大量的等待時間，智微科技推出的一系列產品即為協助客戶解決這個惱人的問題，大幅減少資料傳輸過程所花費的時間並增加資料存取的可靠及安全性，減低因這些等待所產生的額外時間成本。智微科技的晶片於設計時導入許多全新架構與輔助設計，更能簡化客戶開發新產品的困難度與產品驗證時間，加快上市的速度。

智微科技致力於開發更符合市場需求與簡化客戶設計流程的晶片解決方案，經過多年的經營，現已於市場有著近五成的佔有率，著眼於更高速傳輸與大容量存儲擴接的需求，智微科技將繼續於此領域著墨與深耕，期許能持續開發出更新規格與客戶方便應用設計的新一代高速橋接晶片，達成智微與客戶皆能成功的雙贏策略。